

长电科技年产36亿颗高密度系统级封装模组项目厂房顺利封顶

2020年7月7日，长电科技高密度系统级封装模组项目厂房在江苏省江阴市高新技术开发区长电科技城东厂区顺利封顶，新厂房建筑面积超4万平方米，预计2021年1月交付并投入使用，模组封装产品年产量将达36亿颗。



近年来，随着5G技术快速商用，系统级封装模组需求不断扩大，客户订单与日俱增，新厂房建成投入使用后将能更好地满足客户的订单需求。

长电科技CEO郑力先生出席活动并发表讲话，表达了对5G市场及新厂房项目未来的展望。经过一系列的集团内部资源整合与调整，长电科技核心竞争力得到进一步提升，公司业绩实现了快速增长。高密度系统级封装模组项目将进一步提升长电科技的高端封装技术能力与产能。

长电科技执行副总裁罗宏伟先生、集成电路事业中心兼星科金朋江阴厂总经理李全兵先生、长电先进总经理张国栋先生、相关建设单位领导也出席了此次新厂房的封顶仪式。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/160550.html>